



股票代碼：3580

# 友威科技 營運簡報

Date : 114/12/24

投資人關係聯絡方式：

E-mail : [theresachen@uvat.com](mailto:theresachen@uvat.com)

**UVAT**  
Vacuum Ecosystems

# 會議流程

01

公司沿革

02

技術分享與產品

03

經營實績

04

未來展望

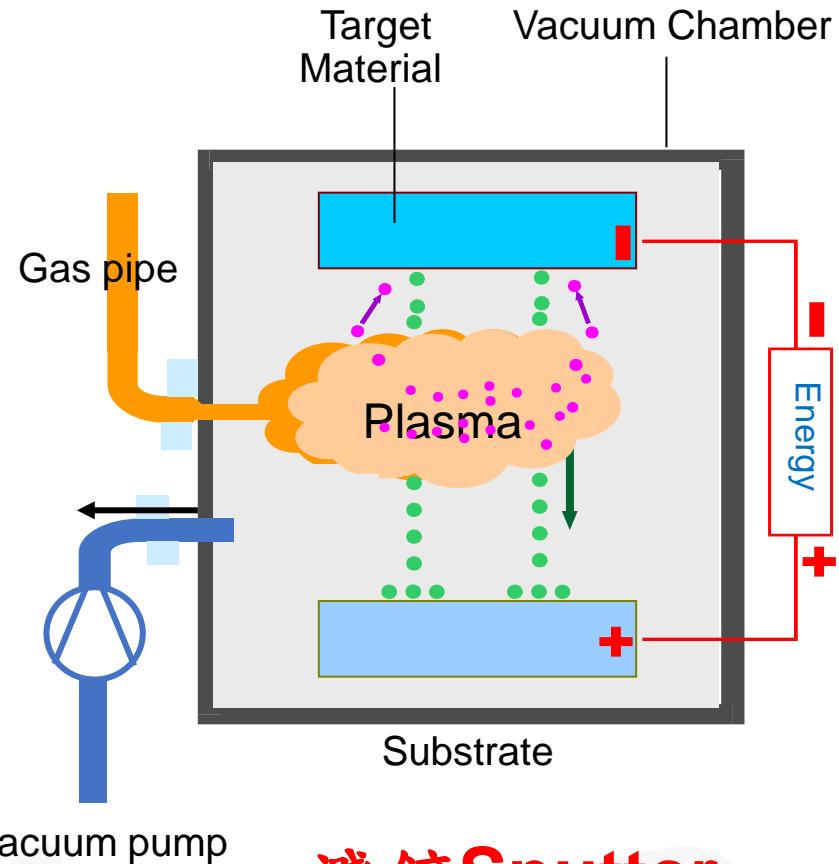




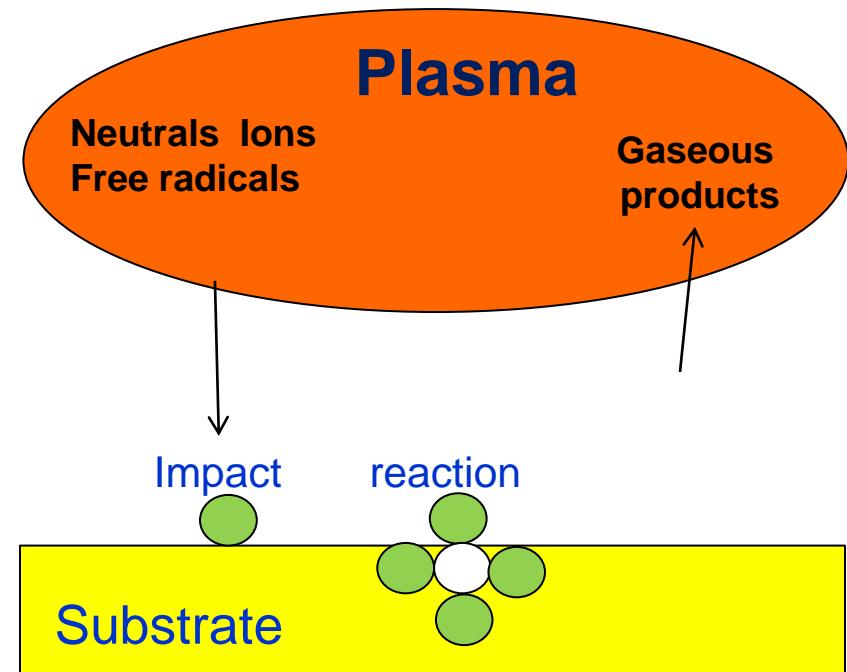
# 01

## 公司沿革

# 乾式(Dry)製程的解決方案

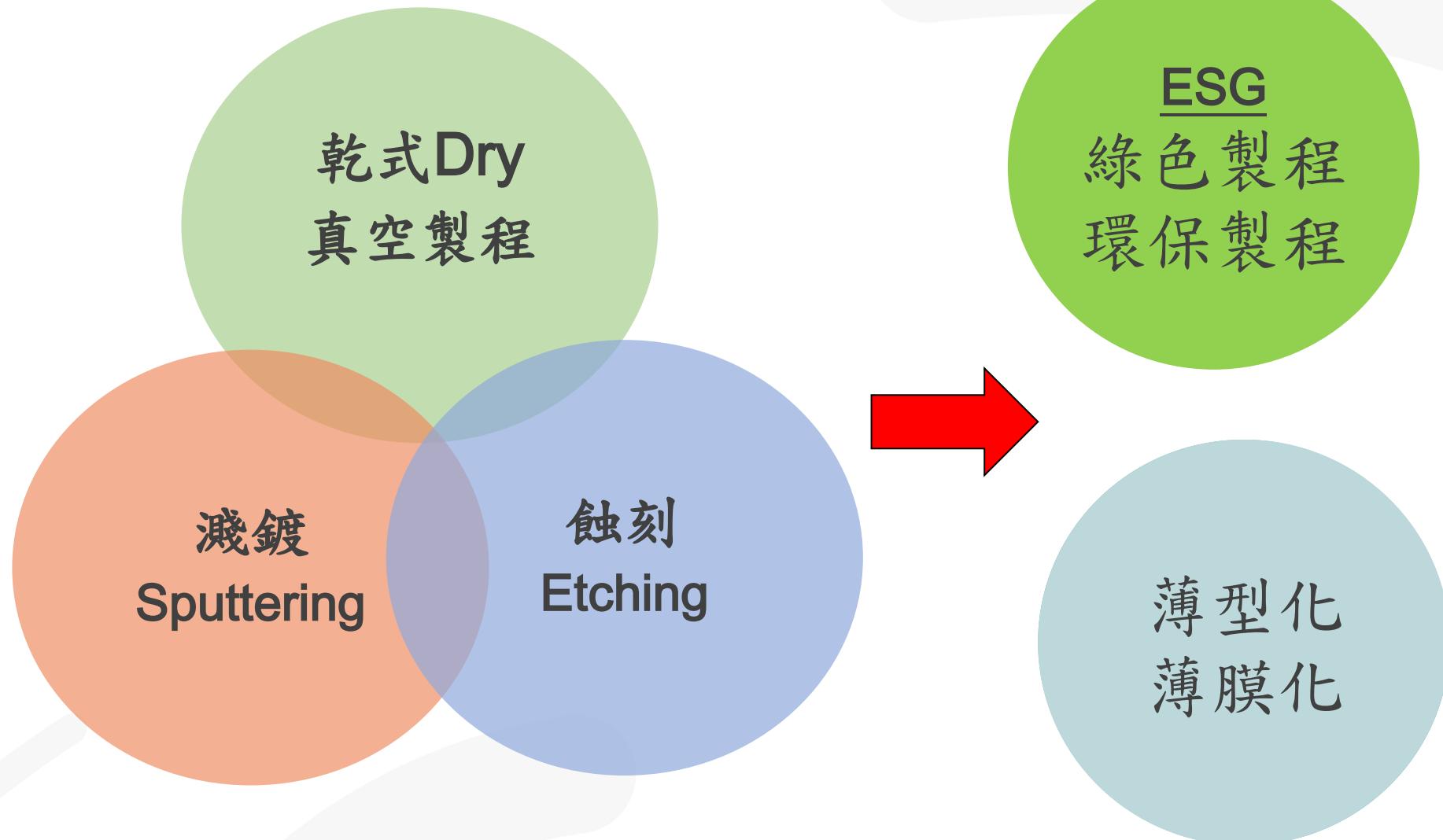


濺鍍 Sputter



電漿蝕刻 Plasma Etch

# 友威的核心



# 關於友威

成立時間	2002/11/04
董事長	李原吉
資本額	新台幣3億9,470萬
員工	台灣：120人 海外：約150人
服務項目	真空濺鍍設備 蝕刻設備 半導體設備及相關耗材 鍍膜代工 光學鍍膜 薄膜元件



- ❖ 2007年股票公開發行
- ❖ 2008年Forbes亞太200大最佳中小企業
- ❖ 2010年7月9日股票上櫃(友威科3580)

# 營運據點



## ■ 台灣

- 位址：台中
  - 研發中心
  - 設計中心
  - 設備製造
  - 客戶服務



- 位址：桃園
  - 漑鍍代工
  - 客戶服務



## ■ 馬來西亞

- 位址：麻波 Muar
  - 客戶服務
  - 業務拓展



## ■ 中國

- 位址：重慶
  - 漫鍍代工
  - 客戶服務



- 位址：深圳
  - 漫鍍代工
  - 客戶服務

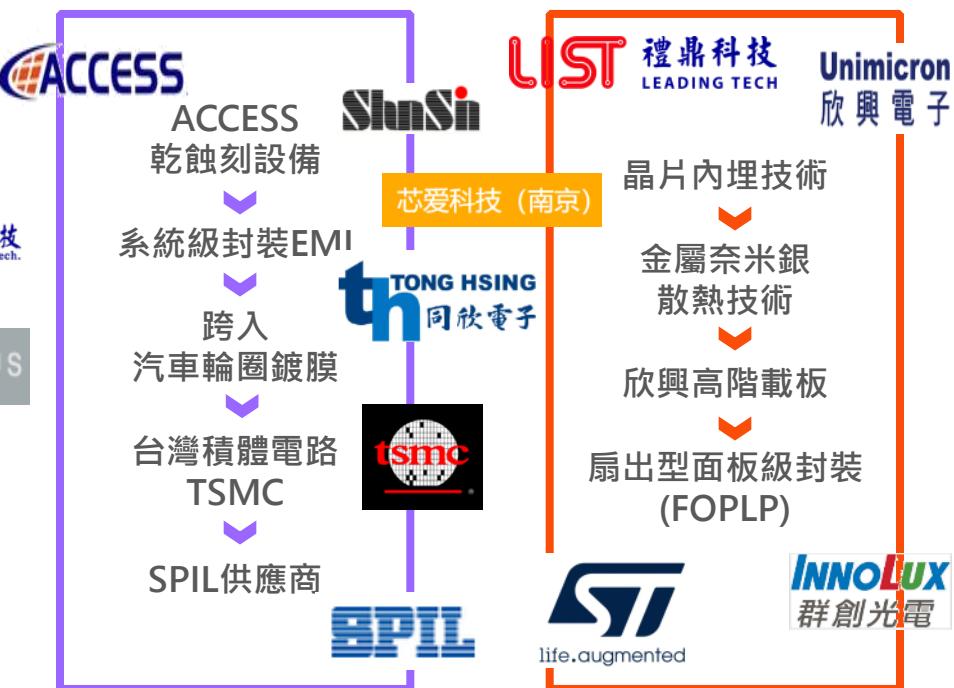
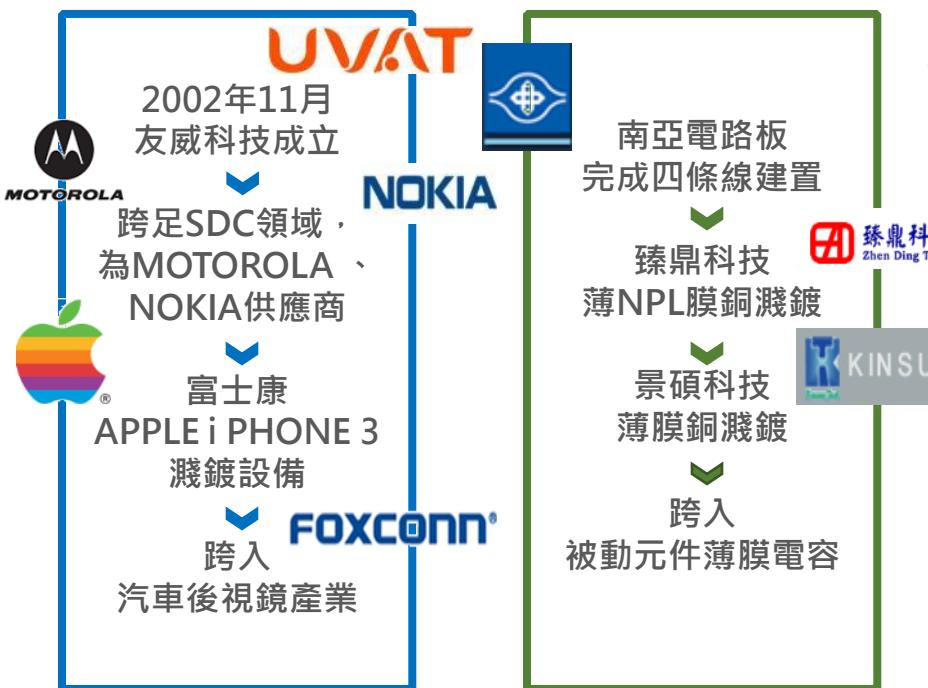
# 里程碑

2002-2012

2012-2017

2017-2022

2022~



# 核心價值及服務

全面服務  
妥善率最高

創新服務價值

共同開發

專業售服

實驗模擬

開發時間快

UVAT

自動化&  
智慧製造

系統整合

設計規劃

滿足客戶需求  
創造高CP值

# 台灣精品獎

**UVAT**

產業類別：生產力&能源精品

產品型號：鈦銅種子層濺鍍機

連續式真空濺鍍機

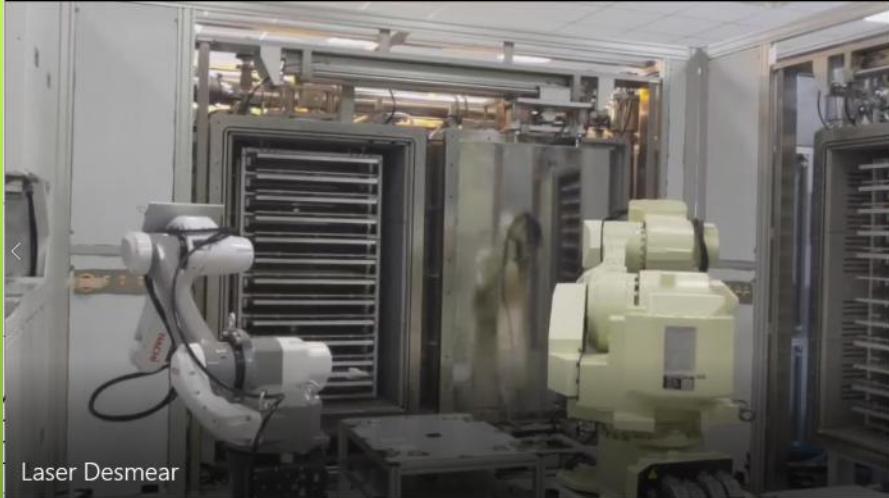


台灣精品 2021  
TAIWAN EXCELLENCE



# 蝕刻 Dry Etch

- Panel level plasma treatment



- High aspect ratio plasma descum



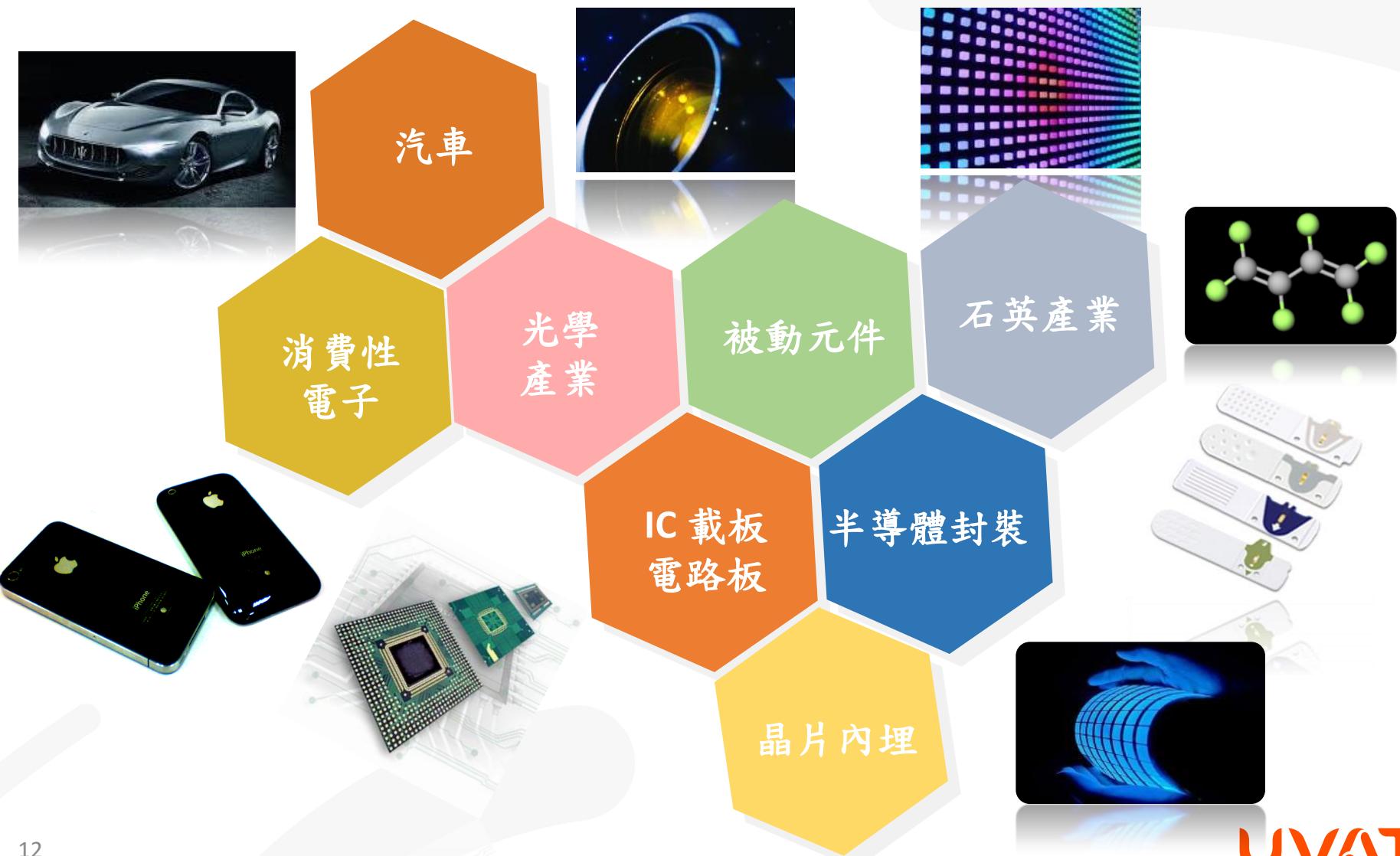
第九屆經濟部  
國家產業創新獎

經濟部-  
中小企業創新研究獎

- Fine pitch metal etch

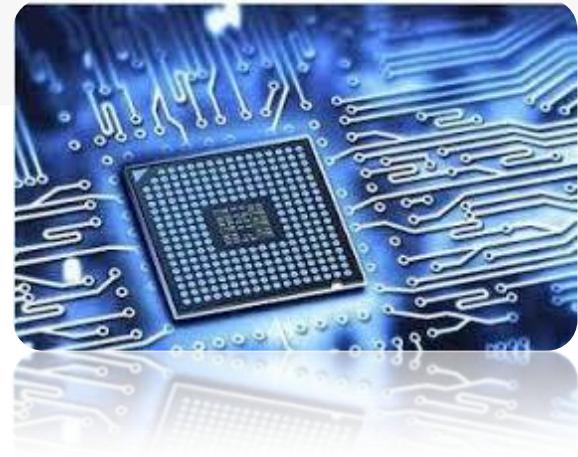


# 產品應用的市場



# 主要應用

Semi半導體  
CoWoS  
FOPLP



消費性電子  
光學鍍膜



元件

- 被動元件
- 石英元件
- 散熱元件
- 光學元件
- HUD元件

**UVAT**



02

技術分享與產品

# 小孔徑除膠渣 Small Via Desmear

## ■ 目的

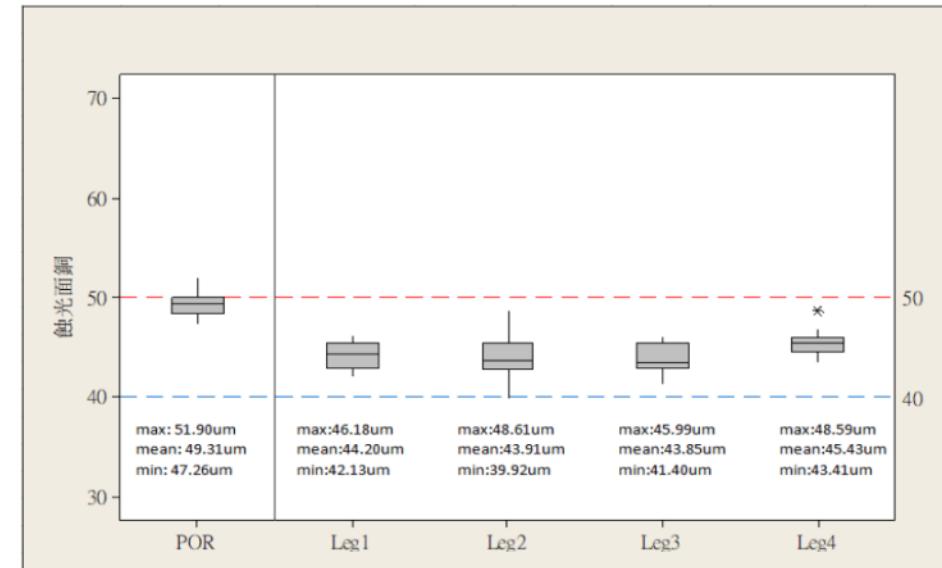
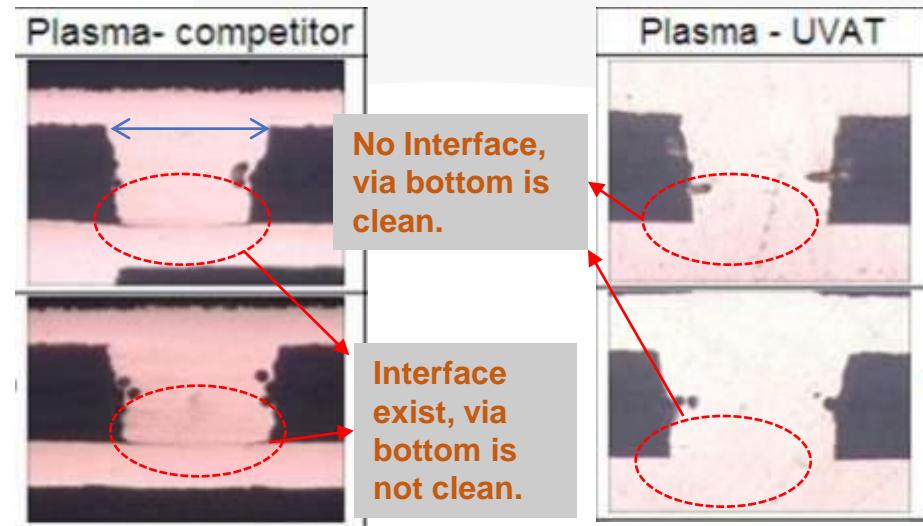
- PP Desmear
- 電鍍後孔底殘留確認

## ■ Film structure 開窗規格

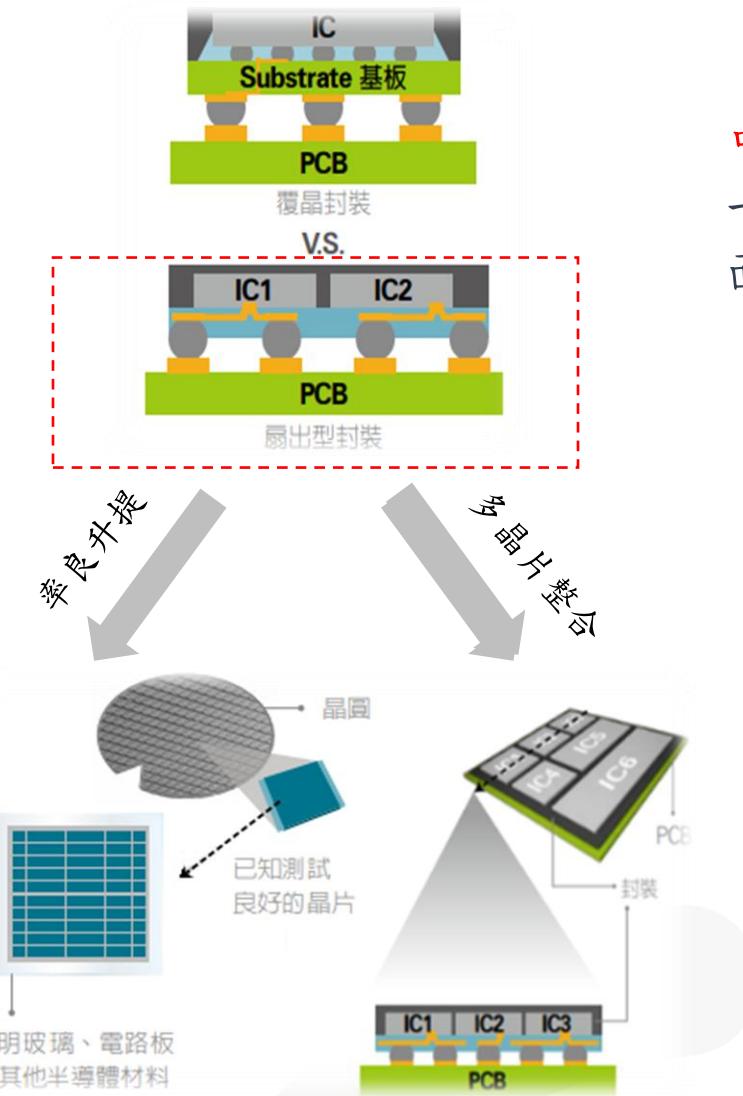
- Pattern width : 40um
- Pattern high : 40um

## ■ 測試結果

- 蝕刻機可完全移除PP材料
- 透過SEM檢測確認



# 高階封裝應用\_FOPLP



中高階載板供應不足下，驅使無載板、可一次性大面積封裝且有效降低製造成本的面板級封裝 **FOPLP** 應用備受矚目。

優勢：

- 挑出良好IC進行封裝，提升良率
- 多晶片異質晶片整合
- 縮小封裝體積
- 大面積封裝降低成本

# 玻璃基板Glass Core及 TGV

Plasma for RDL

表面改質/孔底清潔

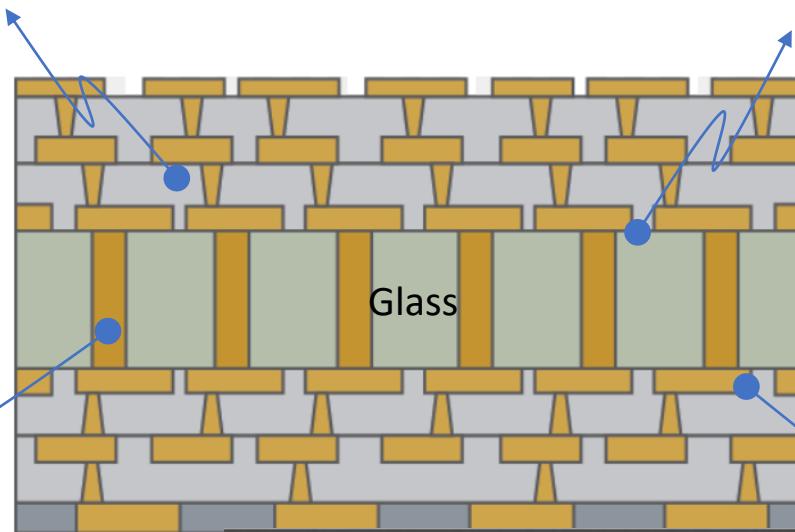
PE-01 Series

PE-02 Series

PE-03 Series

PE-01 Series

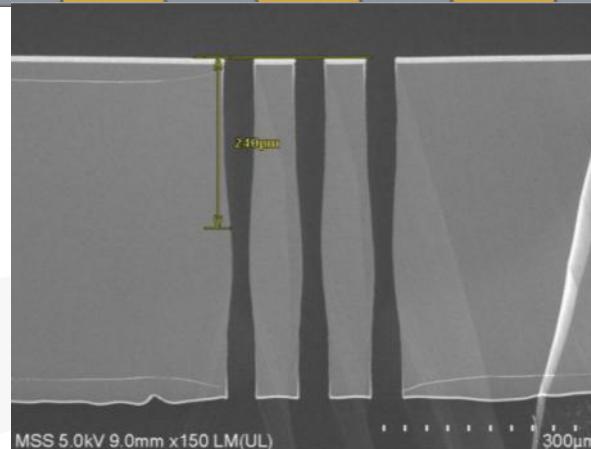
電漿表面改質



種子層鍍膜\_Ti/Cu



玻璃鑽孔  
(Glass Via Drilling)



UVAT

# Advanced Package

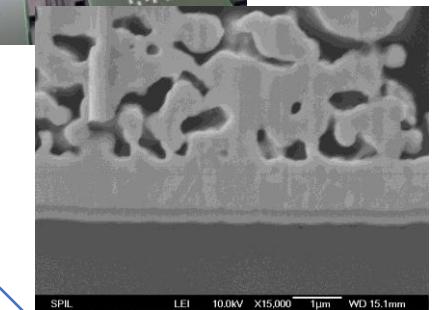
## SIP EMI

SUS/Cu/SUS



## Thermal Dissipation

Ti/NiV/Ag, Ti/NiV/Au



## Plasma Etcher

- Ti/Cu Seed Layer Dry Etch
- Plasma Descum
- Plasma Pre-treatment



## Seeding Sputter

Ti/Cu

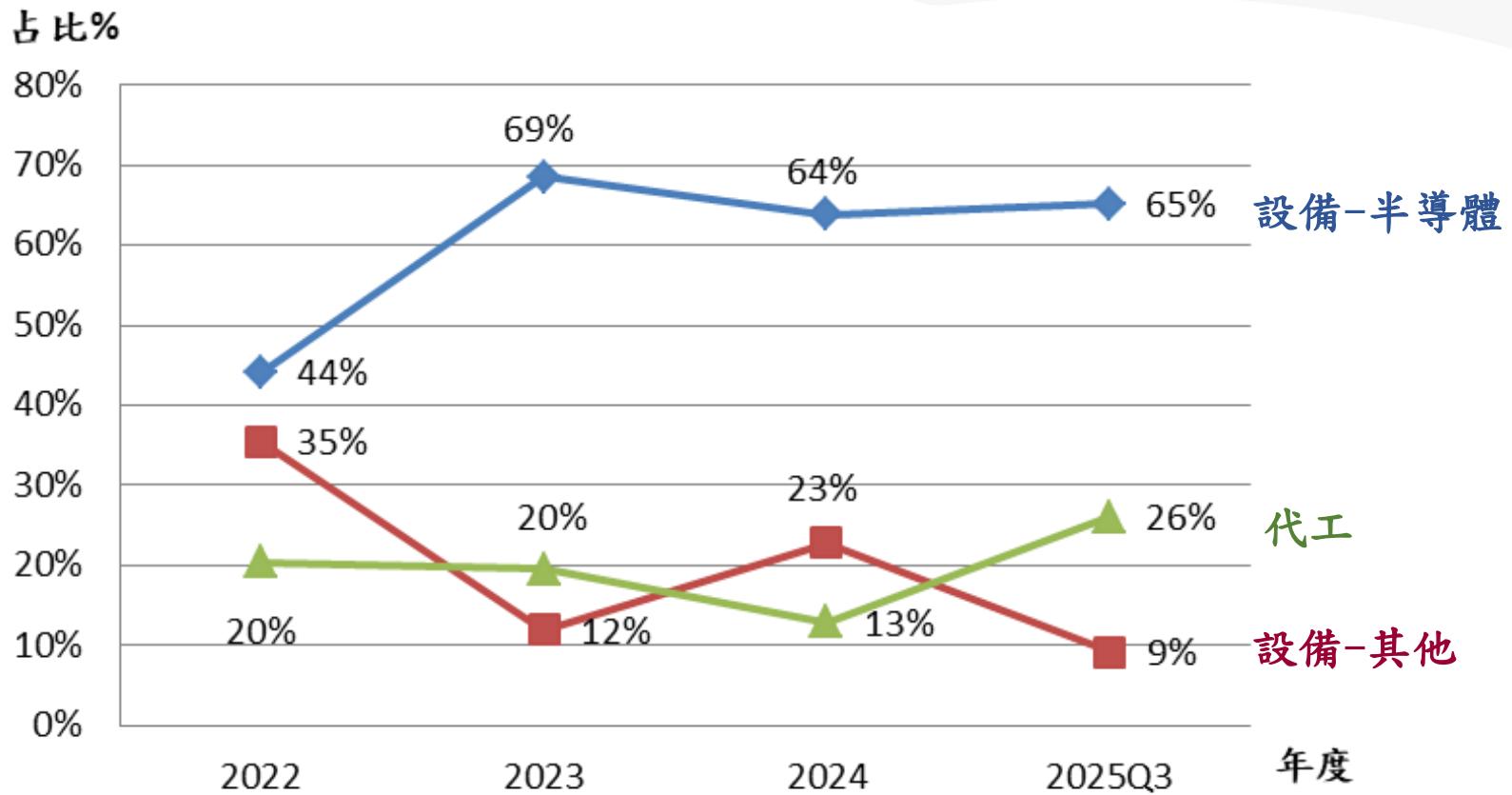




03

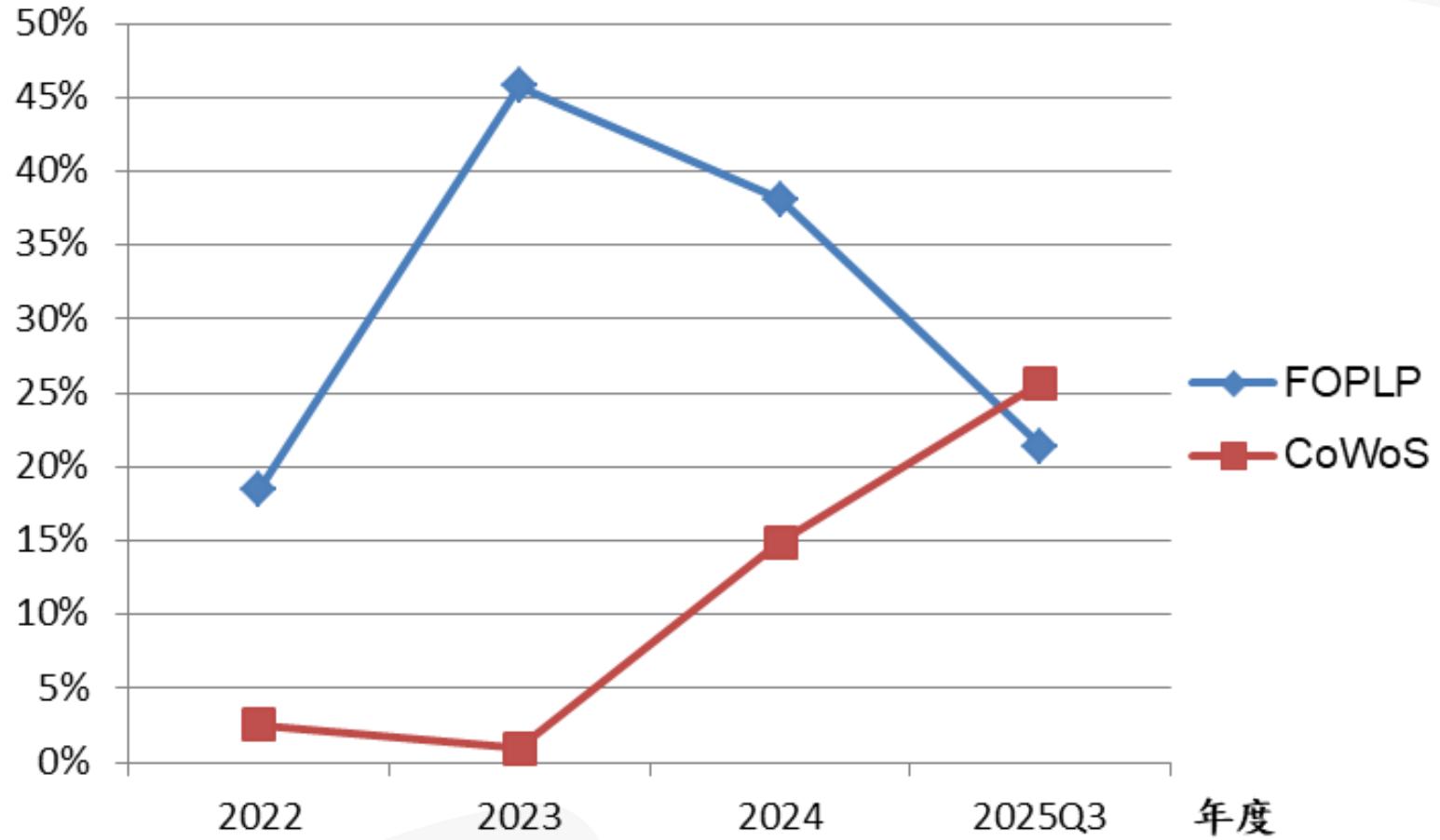
## 經營實績

# 2022~2025Q3產品占比趨勢



\*2025年設備營收占比達74%，其中半導體設備達65%

# 2022~2025Q3 FOPLP及CoWoS占比趨勢



\*2025年CoWoS營收占比首度超越FOPLP產品

# 2022~2025Q3簡明損益表

單位：NTD仟元

年度	2022	%	2023	%	2024	%	2025Q3	%
營業收入	1,038,477	100%	744,579	100%	660,171	100%	317,797	100%
營業成本	561,008	54%	433,846	58%	374,054	57%	157,039	49%
營業毛利	477,469	46%	310,733	42%	286,117	43%	160,758	51%
營業費用	200,726	19%	187,679	25%	187,655	28%	88,515	27%
營業淨利	276,743	27%	123,054	17%	98,462	15%	72,243	23%
稅前淨利	328,355	32%	133,343	18%	132,618	20%	71,786	23%
稅後淨利	247,299	24%	102,216	14%	198,176	30%	57,439	18%
EPS	6.37		2.63		5.08		1.46	

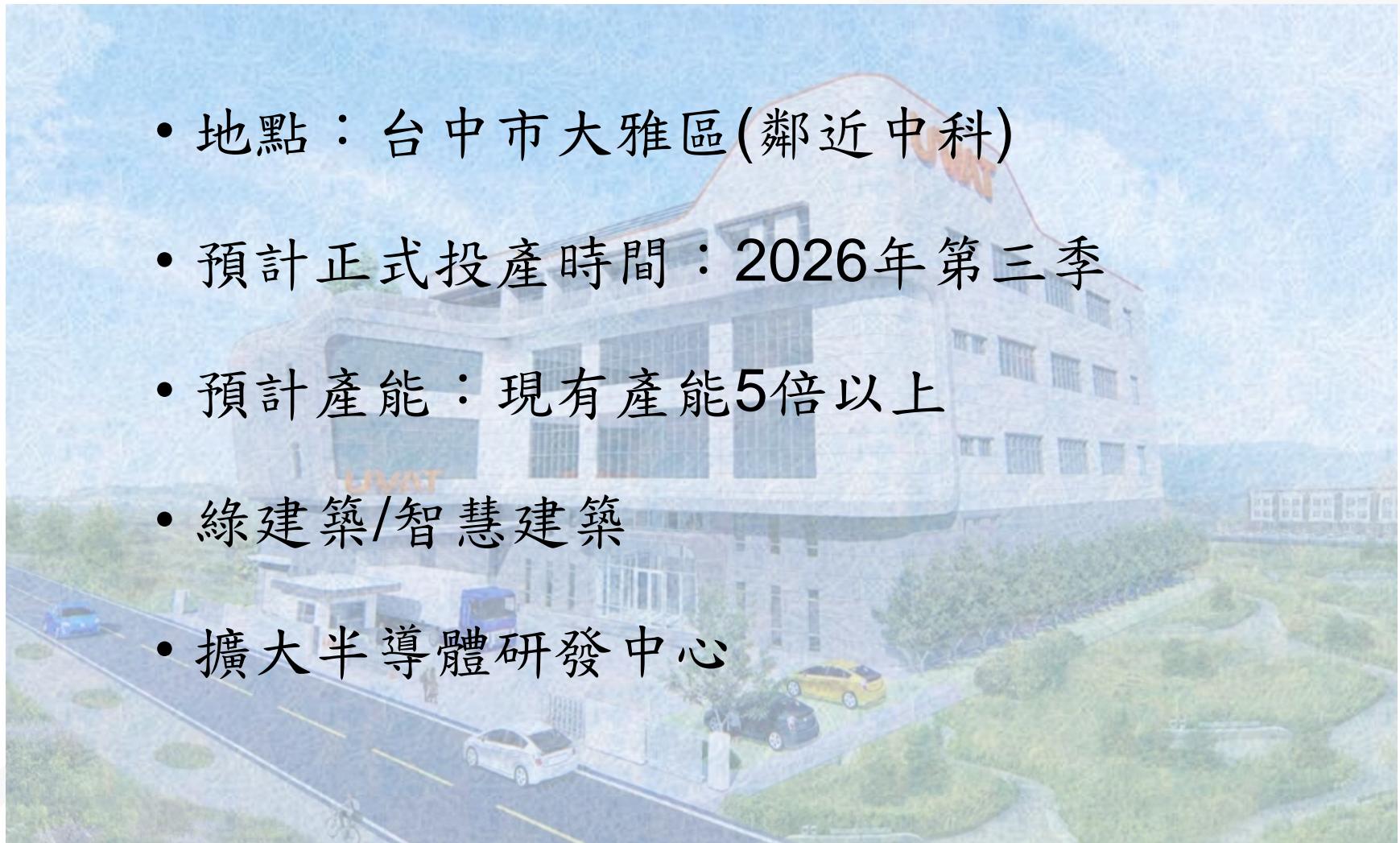


# 04

## 未來展望

# 重大資本支出-企業總部

- 地點：台中市大雅區(鄰近中科)
- 預計正式投產時間：2026年第三季
- 預計產能：現有產能5倍以上
- 綠建築/智慧建築
- 擴大半導體研發中心



# 德鑫半導體聯盟



德鑫：鄭智文、王年清、闢聖哲、吳騰彥、邱銘乾、黃銘文、吳明致、周傳華

德鑫貳：林文彬、李傳德、朱明癸、詹文雄、莊明郎、林守堂、陳勲森、簡榮坤、洪誌宏、李原吉

2025年2月26日於台北

布局美國及日本



# 免責聲明

- ◆ 本公司基於內部資料及預測性資訊，包括營運狀況、業務素狀與種經。本公司基於內部資料及預測性資訊，包括營運狀況、業務素狀與種經。

# UVAT

Vacuum Ecosystems

## Thank you

友威科技股份有限公司

UVAT Technology Co., Ltd.

